

Nichem[®] MP 1188

Mittelphosphorhaltiges chemisch Nickel-Verfahren



Oberflächenveredelung

Chemisch Nickel

www.atotech.com



Fortschrittliches, ELV-, RoHS- und WEEE-konformes, mittelphosphorhaltiges chemisch Nickel-Verfahren

BLEI-
frei

CADMIUM-
frei

Ein zukunftsweisender Schritt in der chemisch Nickel-Beschichtung

Die Nachfrage nach modernen chemisch Nickel-Beschichtungen ist hoch und die Anwendungsbereiche variieren von der Serienfertigung im Automobilbereich bis zu Kleinserien bei Lohnbeschichtern. In der Vergangenheit wurde der chemisch Nickel-Prozess entsprechend der Anwendung gewählt und angepasst – aber nicht mehr heute. Atotech ist stolz darauf, Nichem[®] MP 1188 vorzustellen, ein hochglänzendes, ELV-, RoHS- und WEEE-konformes mittelphosphorhaltiges chemisch Nickel-Verfahren, das die höchsten Produktionsanforderungen erfüllt aber über die erforderliche Flexibilität zur Beschichtung verschiedenster Oberflächen und Basismaterialien verfügt – ein Allround-Prozess.

Hochleistungsfähiger mittelposphorhaltiger chemisch Nickelprozess mit sehr geringer Badbelastung



Prozesseigenschaften

Nichem® MP 1188 wurde speziell für Anwendungen mit sehr geringer Badbelastung entwickelt und erzielt exzellente Abscheidungen auf Kupfer und Messing. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Zinkkontaminationsbeständigkeit, die eine direkte Beschichtung von Zinkat/ Aluminium-Legierungen über die gesamte Bad-Standzeit ohne Glanz- oder Haftungsverluste ermöglicht. Das Verfahren ist pH-selbstregulierend und überzeugt durch eine einfache Prozessüberwachung.

Abscheidegeschwindigkeiten

Eine Nichem® MP 1188 Schicht enthält 6-8 % Phosphor und erzielt einen Härtegrad von 550 - 650 HV0.1. Das Verfahren gewährleistet über die gesamte Badstandzeit einen konstanten Glanzgrad und kann auf einer Vielzahl von Metallen abgeschieden werden. Die Abscheidungen sind komplett blei- und cadmiumfrei und erfüllen alle gegenwärtigen Regularien gemäß ELV, RoHS und WEEE.

Eigenschaften und Vorteile

- Blei- und cadmiumfrei (ELV- und WEEE-/RoHS-konform)
- Großes Arbeitsfenster
- Einfache Prozessführung für weniger anspruchsvolle Oberflächen
- Stabiles Verfahren auch für sehr anspruchsvolle Oberflächen
- Exzellente Abscheidung auf Messing und Kupfer
- Extrem hohe Beständigkeit gegenüber Zinkkontamination
- Geeignet für eine Vielzahl von Basismaterialien
- Konstant hoher Glanzgrad

